

# 具有新型电极结构的功率发光二极管

方奥琪,郭伟玲\*,许昊,邓杰,陈佳昕,孙捷

北京工业大学光电子技术教育部重点实验室,北京100124

**摘要**为进一步提高GaN基发光二极管(LED)的光效,以改进电极结构为研究点,设计并制备了具有叉指型电极形状, 并在P/N电极下刻蚀出电极孔的新型电极结构。该结构使金属电极在P/N电极孔处分别与ITO层和N-GaN层直接接 触,进而提高了器件的电流扩展能力和发光效率。为了得到更优的电流阻挡层(CBL)结构、电极孔尺寸和电极孔间距, 设计了7种不同的器件,并对其进行了光电性能测试。测试结果表明:在150 mA工作电流下,不连续CBL结构不能够有 效改善LED的发光性能;P电极孔尺寸对器件的性能影响不大,当P电极孔间距由20 μm增大为30 μm时,外量子效率 (EQE)和光电转换效率(WPE)分别提升了约5.0%和3.8%;当N电极孔尺寸由17 μm×5 μm减小为10 μm×5 μm时, EQE和WPE分别提升了约6.5%和3.0%;当N电极孔间距由45 μm减小为40 μm时,并未有效改善器件的发光性能。 关键词 光学器件; GaN基发光二极管;光电特性;热可靠性

中图分类号 TN29 文献标志码 A

**DOI:** 10.3788/AOS202242.1923003

## **Power Light-Emitting Diode with Novel Electrode Structure**

Fang Aoqi, Guo Weiling<sup>\*</sup>, Xu Hao, Deng Jie, Chen Jiaxin, Sun Jie

Key Laboratory of Opto-Electronics Technology, Ministry of Education, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China

**Abstract** In order to further improve the luminous efficiency of GaN-based light-emitting diodes (LEDs), a novel electrode structure with an interdigitated electrode and electrode holes etched under the P/N electrode is designed and fabricated, with the improvement of the electrode structure as the research point. In this structure, the metal electrodes are in direct contact with the ITO and the N-GaN layers at the P/N electrode holes respectively, so as to improve the current spreading capacity and luminous efficiency of the device. In order to obtain better current blocking layer (CBL) structure, electrode hole size and electrode hole spacing, seven different devices are designed, and their photoelectric properties are tested. The test results show that under the working current of 150 mA, the discontinuous CBL structure cannot effectively improve the luminescence performance of LEDs. The size of the P electrode hole has little effect on the properties of the device. When the spacing of the P electrode hole increases from 20  $\mu$ m to 30  $\mu$ m, the external quantum efficiency (EQE) and wall-plug efficiency (WPE) increase by about 5.0% and 3.8%, respectively. When the size of the N electrode hole reduces from 17  $\mu$ m×5  $\mu$ m to 10  $\mu$ m×5  $\mu$ m, the EQE and WPE increase by about 6.5% and 3.0%, respectively. When the spacing of the N electrode hole reduces from 45  $\mu$ m to 40  $\mu$ m, the luminescence performance of the device is not effectively improved.

Key words optical devices; GaN-based light-emitting diodes; photoelectric properties; thermal reliability

# 1引言

作为一种固态光源,GaN基半导体发光二极管 (LED)因具有功耗低、寿命长和体积小的特点,被广 泛应用于绿色照明、汽车照明、交通信号显示和高分辨 率显示器等领域中<sup>[14]</sup>。自GaN基LED产生以来,随 着人们研究的深入和科学技术的发展,LED的研发技术不断地得到创新和突破,其能效也得到了快速提升<sup>[5]</sup>。目前,白光LED主要采用蓝光LED芯片与铈掺杂钇铝石榴石(Ce:Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>,简称Ce:YAG)黄色荧光转换材料封装形成<sup>[6]</sup>。2008年,沈光地等<sup>[7]</sup>发现具有优化的环形叉指电极结构的GaN基LED表面温度分

收稿日期: 2022-02-09; 修回日期: 2022-03-26; 录用日期: 2022-04-18

基金项目:国家科技重大专项(2017YFB0403102)

通信作者: \*guoweiling@bjut.edu.cn

## 研究论文

布比较均匀,证明了芯片电流扩展均匀可减小焦耳热 的产生,进而增强器件的可靠性。2013年,Zhou等<sup>[8]</sup> 提出了一种具有不连续的N电极的结构,通过感应耦 合等离子体(ICP)刻蚀,暴露出不连续的N台面,形成 一个多孔式的结构,该结构减少了电极对有源区的损 耗,从而减少了光损耗。在注入电流为350mA下,发 光效率较传统 LED 电极结构提升了 6.7%。2016年, Liu等<sup>[9]</sup>发现螺旋状环形结构电极的环间距越小,电流 密度分布越均匀,在350mA电流驱动下,电极环间距 为 146.25 µm 的 芯 片 具 有 最 大 的 光 电 转 换 效 率 (26.8%)。2017年,吕家将等<sup>[10]</sup>采用叉指型电极下方 插入电流阻挡层(CBL)的结构提高了 LED 的电流扩 展能力。2020年,晁鹏飞等<sup>[11]</sup>发现将N电极形状改变 为扇形结构能提高LED的出光效率,当输入电流为 20 mA时,相比传统 LED 芯片出光效率提高了 6.14%。虽然关于LED电极的研究很多,但是对电极 仍需进一步优化,如P/N电极开孔的大小和间距的优 第 42 卷 第 19 期/2022 年 10 月/光学学报

化。此外,还要研究CBL的连续性对电极性能的影响 等问题。

为了进一步探究具有优化电极结构的功率 LED 的光电特性,本文设计并制备了7种不同电极结构的 LED,并在此基础上进行了5组对照实验,通过变量分 析的方法来比较CBL的连续性、P/N电极孔间距和 P/ N电极孔大小对 LED 光电特性的影响。

# 2 具有新型电极结构的LED的制备

样品的制备流程如图1所示:1)外延片清洗后 ICP刻蚀出N电极台阶和电极孔;2)淀积SiO<sub>2</sub>,光刻 和腐蚀得到CBL图形,电子束蒸发ITO薄膜并对其 进行光刻;3)生长SiO<sub>2</sub>钝化层,并光刻腐蚀得到钝化 层(PV层)图形;4)溅射Cr/Al/Ti/Pt/Ti/Pt/Au 金 属电极,通过剥离工艺形成电极图形<sup>[12]</sup>。其中, MQW代表多量子阱。具体工艺步骤的剖面示意图 如图1所示。



图 1 GaN基LED的制备流程剖面示意图。(a)刻蚀N电极台阶;(b)淀积CBL并制备ITO层;(c)制备钝化层并刻蚀电极窗口; (d)制备金属电极

Fig. 1 Profile diagram of preparation process of GaN-based LED. (a) Etching N electrode step; (b) depositing CBL and preparing ITO layer; (c) preparing passivation layer and etching electrode window; (d) preparing metal electrode

本文制备的具有新型电极结构的LED的尺寸为 700 µm×350 µm,是对蓝光LED芯片用黄色荧光粉封 装形成的白光LED,其采用叉指型电极结构,CBL形 状与P电极形状近似相同。不连续的P/N电极结构是 通过在P/N电极上刻蚀出电极孔,从而使N电极(N-PAD)一部分溅射在N-GaN层上,另一部分溅射在钝 化层(PV层)上,并使P电极(P-PAD)一部分与SiO<sub>2</sub> 钝化层下方的ITO接触,一部分溅射在SiO<sub>2</sub>钝化层 (PV层)上方形成的。不连续CBL结构是通过湿法刻 蚀在原本与P电极形状近似的连续CBL上形成多个 间距、大小相同的间断点形成的。图2为不连续欧姆接触P/N电极在显微镜下的实物俯视图和CBL结构示意图。

为了分析新型电极结构对LED光电特性的影响 并优化出最佳器件电极结构,设计并制备了7种具有 不同电极结构的LED,其编号、参数和对照组的设置 如表1所示。同时,进行了5组对比测试分析,即LED I和LED VII、LED I和LED VI、LED III和LED V、 LED III和LED IV,以及7种具有不同电极结构的 LED。

	表1	器件的结构信息与编号	
Table 1	Structure	information and numbering of device	s

Label	State of CBL	P electrode hole size /(μm×μm)	P electrode hole spacing /μm	N electrode hole size /(μm×μm)	N electrode hole spacing /μm
LED I	Discontinuous	$5 \times 15$	20	$17 \times 15$	37
LED II	Continuous	$5 \times 15$	20	$17 \times 15$	37
LED III	Discontinuous	$5 \times 15$	25	$10 \times 5$	45
LED IV	Discontinuous	$5 \times 15$	25	$10 \times 5$	40
LED V	Discontinuous	$5 \times 15$	25	$17 \times 15$	45
LED VI	Discontinuous	$5 \times 15$	30	$17 \times 15$	37
LED VII	Discontinuous	$10 \times 15$	20	$17 \times 15$	37



图 2 不连续欧姆接触 P/N电极 LED 显微镜图像和 CBL 结构示意图。(a)不连续欧姆接触 P/N电极 LED 显微镜图像;(b)连续 CBL 结构示意图;(c)不连续 CBL 结构示意图

Fig. 2 Microscope image of LED with discontinuous ohmic contact P/N electrode and structural diagram of CBL. (a) Microscope image of LED with discontinuous ohmic contact P/N electrode; (b) structural diagram of continuous CBL structure; (c) structural diagram of discontinuous CBL structure

# 3 实验结果

在环境温度为25℃,工作电流范围为20~600 mA的条件下,对设置的5组对照组进行变电流测试分析,其中每种LED采用了4个芯片结构相同的不同器件以使得实验结果更精确,在结果分析中采用4个LED的均值来分析性能的变化。

## 3.1 不同 CBL 结构的 LED 的变电流测试分析

对常规(连续)CBL结构LED II和不连续CBL结构LED I进行变电流测试,图 3为其外量子效率(EQE)和光电转换效率(WPE)的变化曲线。在150 mA的工作电流下,LED I相比LED II的EQE和WPE仅仅变化了1.4%和0.3%。可以发现,不连续的CBL结构虽然能通过减少SiO<sub>2</sub>的用量来降低器件的电压,但是当CBL不连续时,通过CBL间隙所注入的载流子会在电极正下方的有源区中复合发光,并且这一部分光会被P电极吸收<sup>[13]</sup>,进而这部分光对整体的EQE与WPE的影响不大。



图 3 LED I与 LED II的 EQE 和 WPE 随电流的变化 Fig. 3 EQE and WPE of LED I and LED II varying with current

## 3.2 具有不同 P电极孔大小或间距结构的 LED 光电 性能研究

3.2.1 相同P电极孔间距、不同P电极孔大小的LED 光电性能

对比实验LEDI和LEDVII的P电极孔尺寸分 别为5µm×15µm和10µm×15µm,测得的器件外 量子效率(EQE)和光电转换效率(WPE)如图4所 示。当P电极孔大小由5µm×15µm增大到10µm× 15µm,150mA电流下的EQE和WPE分别降低了约 1.2%和2.0%。综合误差考虑,认为P电极孔的尺寸 对器件的综合性能影响不大。这是因为虽然P电极 孔的尺寸增大能够使器件的P电极与ITO的欧姆接 触面积增大,但相对于较小的P孔尺寸,增加的P孔 尺寸反而对电流注入的均匀性起到负作用,而器件的 电流注入更加均匀,可以减少器件有源区的产热<sup>[13]</sup>, 所以综合来看P电极孔的尺寸对器件的发光性能影 响不大。



图 4 LED I与 LED VII的 EQE 和 WPE 随电流的变化 Fig. 4 EQE and WPE of LED I and LED VII varying with current

## 研究论文

3.2.2 相同P电极孔大小、不同P电极孔间距的LED 光电性能

对比实验LEDI和LEDVI的孔间距分别为 20µm和30µm,图5为该情况下EQE和WPE随电流 的变化曲线。在150mA的工作电流下,当P电极孔间 距从20µm增大到30µm时,LEDVI比LEDI的EQE 和WPE分别提升了约5.0%和3.8%。这是因为P电 极孔间距由20µm增加到30µm时,电流扩展均匀性 更好,即电流密度减小,抑制了LED的droop效应,此 时发光性能有所提升。然而,当P电极孔间距由 20µm增加到30µm时,P电极与ITO薄层的接触面积 减小,这会导致串联电阻增加,进而可能会造成器件的 热阻与结温升高,但从器件的发光性能出发,增加P电 极孔的间距是一种有效提升LED性能的方法。



图 5 LED I与LED VI的EQE和WPE随电流的变化 Fig. 5 EQE and WPE of LED I and LED VI varying with current

## 3.3 具有不同 N 电极孔大小或间距结构的 LED 光电 性能研究

3.3.1 相同 N 电极孔间距、不同 N 电极孔大小的 LED 光电性能

对比实验 LED III 和 LED V的 N 孔尺寸分别为 10 µm×5 µm 和 17 µm×15 µm。图 6 为两者 EQE 和 WPE 随电流的变化曲线,随着 N 电极孔尺寸的减小, 有源区的有效发光面积在增大,LED III 的光电特性显 著提升,150 mA 工作电流下的 EQE 和 WPE 相较 LED V分别提升约 6.5%和 3.0%。同时,N 孔尺寸的 增加也有利于增大 N 电极与 N-GaN 层的欧姆接触面 积,使器件的电压降低,并改善器件的结温和热阻。由 此可见,在一定程度上缩小 N 电极孔的尺寸,是一种有 效提升 LED 性能的方法。

3.3.2 相同 N 电极孔大小、不同 N 电极孔间距的 LED 光电性能

对比实验 LED III 和 LED IV 的 N 孔间距分别为 45 µm 和 40 µm。图 7 为不同电流下两者的 EQE 与 WPE 的对比图。可以发现,当 N 电极孔间距由 45 µm 减小为 40 µm 时,150 mA 的工作电流下 EQE 和 WPE 仅提升约1.8%和1.4%。性能提升的原因主要由两 方面构成:减小 N 电极孔的间距后,电极孔数量会增加 一个,N 电极与 N-GaN 层的接触面积增大,器件的阻 抗减小,进而使器件的电压降低,热阻与结温也可能会





有所降低;N孔数量的增加又会导致器件的有源区面 积的损失。综合误差考虑,认为N孔间距对改善器件 发光特性的效果不明显。



图 7 LED III与 LED IV的 EQE 和 WPE 随电流的变化 Fig. 7 EQE and WPE of LED III and LED IV varying with current

#### 3.4 7种不同结构 LED 的光效对比

为了获得7种LED器件的最佳结构,图8为7种 不同电极结构的LED的光效随电流的变化关系曲线。 可以看出,CBL的连续性、P电极孔尺寸和N电极孔间 距对器件的光电性能影响较小,而改变P电极孔间距 和N电极孔尺寸能够对LED的光电性产生显著的 影响。

# 4 结 论

设计并制备了不同电极形状的LED,并对其进行 了光电热特性的测试分析研究。对5组对比实验数据 进行作图和综合分析,结果表明:LED的电流阻挡层 可以设计为与P电极形状相似的连续图形,有利于提 升器件的光电性能;P电极孔尺寸的减小和N电极孔 间距的减小在一定程度上可以提升LED性能,但对总 体光电性能的影响不大;P电极孔间距和N电极孔尺 寸的改变能够对LED的光电性能产生显著影响。在 150 mA的工作电流下:当P电极孔间距从20  $\mu$ m增大 到 30  $\mu$ m时,器件的EQE和WPE分别提升约5.0%和 3.8%;当N电极孔尺寸由17  $\mu$ m×5  $\mu$ m 耐,器件的EQE和WPE分别提升约 6.5%和3.0%。综合对比所制备器件的所有测试数



图 8 7种不同电极结构的LED的EQE和WPE随电流的变化。(a) EQE;(b) WPE Fig. 8 EQE and WPE of LED with 7 different electrode structures varying with current. (a) EQE; (b) WPE

据发现,改变P电极孔间距和N电极孔尺寸对LED光 电性能的提升较为有效,而P电极孔尺寸和N电极孔 间距对器件光电性能的影响较小。

#### 参考文献

- Tsai H Y, Su F C, Chou C H, et al. Wearable inverse light-emitting diode sensor for measuring light intensity at specific wavelengths in light therapy[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 68(5): 1561-1574.
- [2] Anthopoulou E, Doulos L. The effect of the continuous energy efficient upgrading of LED street lighting technology: the case study of Egnatia Odos[C]//Second Balkan Junior Conference on Lighting (Balkan Light Junior), September 19-21, 2019, Plovdiv, Bulgaria. New York: IEEE Press, 2019.
- [3] 江孝伟,赵建伟,武华.高光提取效率倒装发光二极管的设计与优化[J].激光与光电子学进展,2018,55(9): 092302.

Jiang X W, Zhao J W, Wu H. Design and optimization of flip-chip light-emitting diode with high light extraction efficiency[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2018, 55(9): 092302.

[4] 班章,梁静秋,吕金光,等.微型倒装 AlGaInP发光二
 极管阵列器件的光电性能[J].光学学报,2018,38(9):
 0923001.

Ban Z, Liang J Q, Lü J G, et al. Photoelectric characteristics of micro flip-chip AlGaInP light emitting diode array[J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(9): 0923001.

- [5] 李梦梅,胡小玲,郭伟玲.GaN基LED能效的研究进展
  [J].照明工程学报,2020,31(1):8-15.
  Li M M, Hu X L, Guo W L. Research progress on energy efficiency of GaN-based LEDs[J]. China Illuminating Engineering Journal, 2020, 31(1): 8-15.
- [6] 唐燕如,赵帝,易学专,等.电流与温度对蓝光LED和 白光LED发光性能的影响[J].中国激光,2021,48(21): 2103003.

Tang Y R, Zhao D, Yi X Z, et al. Current and temperature effects on luminescence properties of blue

and white LEDs[J]. Chinese Journal of Lasers, 2021, 48 (21): 2103003.

[7] 沈光地,张剑铭,邹德恕,等.大功率GaN基发光二极 管的电流扩展效应及电极结构优化研究[J].物理学报, 2008,57(1):472-476.

Shen G D, Zhang J M, Zou D S, et al. Research on effects of current spreading and optimized contact scheme for high-power GaN-based light-emitting diodes[J]. Acta Physica Sinica, 2008, 57(1): 472-476.

- [8] Zhou S J, Wang S F, Liu S, et al. High power GaNbased LEDs with low optical loss electrode structure[J]. Optics & Laser Technology, 2013, 54: 321-325.
- [9] Liu L, Hu X L, Wang H. N-type electrode patterns design and device fabrication of GaN-based vertical structure LEDs[J]. Chinese Journal of Luminescence, 2016, 37(3): 338-345.
- [10] 吕家将,郑晨居,周圣军,等.LED电极结构优化设计 与仿真计算[J].半导体光电,2017,38(4):483-487.
  Lü J J, Zheng C J, Zhou S J, et al. Optimization design and simulation calculation of LED electrode structure[J]. Semiconductor Optoelectronics, 2017, 38(4):483-487.
- [11] 晁鹏飞,许英朝,刘春辉,等.GaN基LED芯片电极结构的优化及制备[J].激光与光电子学进展,2020,57(7):072301.
  Chao P F, Xu Y C, Liu C H, et al. Optimization and preparation of GaN-based LED chip electrode structure [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57(7):
- [12] 邓杰.高能效LED电极优化及器件制备技术研究[D]. 北京:北京工业大学,2020.
  Deng J. Research on optimization of high energy efficiency LED electrode and fabrication technology[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2020.

072301.

[13] 曹伟伟,朱彦旭,郭伟玲,等.不同形状的电流阻挡层 对 GaN 基 LED 光效的影响[J].发光学报,2013,34(4): 480-483.

Cao W W, Zhu Y X, Guo W L, et al. Improving luminous efficacy of the GaN-based light-emitting diodes by using different shapes of current blocking layer[J]. Chinese Journal of Luminescence, 2013, 34(4): 480-483.